|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版本： | 1:00 |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| CFP8文档说明 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 共5页 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 2017年7月 | | | | |

目次

[1 引言 1](#_Toc488244463)

[1.1 编写目的 1](#_Toc488244464)

[1.2 背景 1](#_Toc488244465)

[2 任务描述 1](#_Toc488244466)

[3 协议约定 2](#_Toc488244467)

[3.1 炉温控制 2](#_Toc488244468)

[3.1.1 硬件交联 2](#_Toc488244469)

[3.1.2 通讯配置 2](#_Toc488244470)

[3.1.3 通讯协议 2](#_Toc488244471)

[3.2 测试控制 3](#_Toc488244472)

[3.2.1 硬件交联 3](#_Toc488244473)

[3.2.2 通讯配置 3](#_Toc488244474)

[3.2.3 通讯协议 3](#_Toc488244475)

[4 测试过程 8](#_Toc488244476)

[5 调试记录 8](#_Toc488244477)

[6 系统部署 8](#_Toc488244478)

# 引言

## 编写目的

本文对CFP8 的需求以及调试的记录进行了简单的说明，可作为日后维护的参考和依据。

本文预期的读者为：

* 项目负责人
* 软件开发人员
* 软件维护人员
* 其他该项目参与人员

## 背景

CFP8测试从QSFP28G更改而来。。

# 任务描述

CFP8从 QSFP28G更改而来，两者基本相同。不同之处在于：CFP8的组件中有BH1，BH2两种配件，不同的配件组成对产品的电流以及burn in 时间有不同的要求。具体见表1：

**表1 需求对应表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Laser type** | **Oven temp (deg)** | **Laser temp (deg)** | **Laser bias(mA)** | **BI duration(hrs)** | **BI plan** | **TEC** |
| CFP8 TOSA | BH1 | 60 | 90 | 80mA (~DAC =119) | 20 | Plan 1 -20hrs | **Yes** |
| BH2 | 60 | 90 | 90mA (~DAC =140) | 92 | Plan 2 -92hrs | **Yes** |
| Mixed BH1/BH2 | 60 | 90 | 90mA (~DAC =140) | 92 | Plan 2 -92hrs | **Yes** |
| QSFP28 CWDM4 Gen2 TOSA | BH2 | 90 | NA | 80mA (~DAC =103) | 92 |  | NO |

说明：

当CFP8由BH1组成时：BI时间：20 hours ,laser bias值：80 mA;

当CFP8由BH1，或者由BH1，BH2混合组成时：BI时间92 hours，laser bias值：90mA。

BH对应的SN号如表2，表3：

表2 BH1芯片

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BH1 芯片** | | | | | | | |
|  | **TOSA0** | | | | **TOSA1** | | | |
| Binning | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| Top | 1256031 | 1256032 | 1256033 | 1256034 | 1264122 | 1264123 | 1264124 | 1264127 |
| -4 | 1272386 | 1272392 | 1272398 | 1272404 |  |  |  |  |
| -3 | 1272387 | 1272393 | 1272399 | 1272405 | 1235254 | 1235261 | 1235268 | 1235276 |
| -2 | 1272388 | 1272394 | 1272400 | 1272406 | 1235255 | 1235262 | 1235269 | 1235277 |
| -1 | 1272389 | 1272395 | 1272401 | 1272407 | 1235256 | 1235263 | 1235270 | 1235278 |
| 0 | 1272390 | 1272396 | 1272402 | 1272537 | 1235257 | 1235264 | 1235271 | 1235279 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 BH2芯片

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BH2 芯片** | | | | | | | |
| **TOSA0** | | | | **TOSA1** | | | |
| L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1261571 | 1261572 | 1261573 | 1261574 | 1261575 | 1261576 | 1261577 | 1261578 |
| 1272539 | 1272545 | 1272551 | 1272557 | 1272563 | 1272570 | 1272576 | 1272582 |
| 1272540 | 1272546 | 1272552 | 1272558 | 1272564 | 1272571 | 1272577 | 1272583 |
| 1272541 | 1272547 | 1272553 | 1272559 | 1272566 | 1272572 | 1272578 | 1272584 |
| 1272542 | 1272548 | 1272554 | 1272560 | 1272567 | 1272573 | 1272579 | 1272585 |
| 1272543 | 1272549 | 1272555 | 1272561 | 1272568 | 1272574 | 1272580 | 1272586 |
| 1272544 | 1272550 | 1272556 | 1272562 | 1272569 | 1272575 | 1272581 | 1272587 |

# 协议约定

与QSFP28G同。

# 测试过程

与QSFP28G同。

# 调试记录

QSFP28G站名：Q28\_Burn In

测试产品SN号：

TW1730P08-00---99

TW1730P09-00---99

TW1730P0A-00---99

TW1730P0B-00---19

CFP8站名：CFP8\_Burn In

测试电脑ID：SHG-D80010620

测试产品SN号：

BH1组成：

TW1727J00-00

TW1727J00-01

TW1727J00-02

BH1与BH1混合组成：

TW1727J01-00

TW1727J01-01

# 系统部署

部署的MES服务，添加了最新的获取组件信息接口。

CFP8部署电脑ID: WUX-D80007549